

2011年度版 日本実装技術ロードマップ報告会

- 主催：Jisso技術ロードマップ専門委員会／実装技術ロードマップG
- 担当部署：知的基盤部
- 参加者数：約230名

概要

「Jisso技術ロードマップ専門委員会」では、「実装技術ロードマップG」を設け、我が国における実装技術の動向及び今後の展望について調査・検討を行っておりますが、今般「2011年度版 日本実装技術ロードマップ」を発行いたしました。

我が国の競争優位性の源泉である実装技術の高付加価値を促進するため、実装業界のみならず、関連する材料や製造装置業界に対して準備すべき、あるいは研究開発すべき技術の方向性や採るべき戦略の方向性を示

唆したガイドブックとしての役割も担っております。実装技術を活用するモノづくりの現場向けのみならず、大学や公設試験研究機関における具体的なテーマについても示しながら、本書の内容について解説を行いました。

報告会は実装技術ロードマップG委員長 高橋邦明氏の挨拶を皮切りに以下のようなプログラムで進められました。

プログラム

- 開会の挨拶
高橋邦明氏（エスベック（株））
- 「機器セットの実装技術動向」
間仁田祥氏（カシオ計算機（株））
- 「半導体パッケージの技術動向」
今村和之氏（富士通セミコンダクター（株））
- 「電子部品の技術動向」
梶田 栄氏（（株）村田製作所）
- 「プリント配線板の技術動向」
宇都宮久修氏（インターコネクションテクノロジーズ（株））
- 「実装設備の技術動向」
井上高宏氏（パナソニック ファクトリーソリューションズ（株））
- 「トピックス・環境対応実装技術の動向」
青木正光氏（NPO法人 日本環境技術推進機構）

